

JPCA 2024 Show

第53回国際電子回路産業展

JIEP マイクロエレクトロニクスショー

第38回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2024

第25回 実装プロセステクノロジー展

METaverse Device Expo  
メタバースデバイス展

～装置と装置をつなぐ～  
Wi WIRE Japan Show 2024  
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show

JEP 全国電子部品流通連合会  
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable  
イーテキスタイル/ウェアラブル展

Smart Sensing  
スマートセンシング

無人化ソリューション展

Edge Computing  
エッジコンピューティング



出展の  
ご案内

# 電子機器2024 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2024

## 2024. 6. 12 Wed. → 14 Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟 | Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

出展申込受付開始：2023年11月1日（水）10:00～



展示会公式サイトへ

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、  
一般社団法人日本ロボット工業会  
共催：電子デバイス産業新聞 [(株)産業タイムズ社]、電線新聞 [(株)工業通信]、  
(株)JTBコミュニケーションデザイン、  
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合、株式会社社織研新聞社、  
後援(予定)：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体  
中国電子回路行业协会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、インド電子工業会 (ELCINA)、  
香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、インド電子回路工業会 (IPCA)、  
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、タイ電子回路工業会 (THPCA)、  
台湾線路板協会 (TPCA)

Association of Electronic Industries in Singapore (AEIS)  
Korea Packaging Integration Association (KPIA)

2023/10/20版

# エレクトロニクスの機能を具現化する 全てがココにある!!

最先端の電子回路基板、実装、装置、プロセス、そして電子部品を誇る500社(予定)が集い、世界最高峰の技術に触れる機会をご提供致します。




## 開催概要

会期	2024年6月12日(水)~14日(金) 午前10時~午後5時		
会場	東京ビッグサイト 東展示棟	本部事務局	一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA)
入場料	1,000円(税込) ※WEB登録で無料	運営事務局	株式会社JTBコミュニケーションデザイン


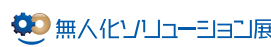

## 最先端のアプリケーションに関する企画を多数開催

電子回路基板、実装、関連装置、材料/プロセス、自動運転向け高速伝送技術、EV向け大電流技術、アドバンスドパッケージング技術、パワー半導体・ガラス基板向け材料/プロセス技術、気候変動対策に寄与する低エミッション技術、E-Textile/Wearable技術、センサー&センシング技術、無人化技術/ソリューション、Edge Computing/オンデバイス技術、等

## 構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術
 <p>第53回国際電子回路産業展</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●プリント配線板技術展 電子回路基板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)</li><li>●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵基板、部品内蔵に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)</li><li>●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)</li><li>●機器・半導体受託生産システム展 EMS・ODM及び半導体の受託生産に関するサービス・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)</li></ul> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会	 <p>マイクロエレクトロニクスショー</p> <p>第38回 最先端実装技術・パッケージング展</p> <p>実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージング/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)</p> 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会	 <p>第25回 実装プロセステクノロジー展</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオープン)、ティスベンサ</li><li>■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ、その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤</li><li>■半導体実装機：システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム</li><li>■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR</li><li>■検査・試験装置：基板外観検査装置 半導体製造関連検査・測定装置</li><li>■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置</li><li>■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材料</li><li>■実装接合システム・はんだ/接合材料</li><li>■高周波対応装置・部品、材料 ■環境関連装置・材料</li></ul> 主催：一般社団法人日本ロボット工業会

メタバースデバイス	電気・光伝送技術	半導体・電子部品	高機能テキスタイル
 <p>メタバースデバイス展</p> <p>メタバースに関する製品・技術全般(半導体(プロセス)、メモリ、センサー)、AR・VR・MRゴーグル/ディスプレイ(マイクロLED、有機EL)/カメラ/ヘッドセット/コントローラー、冷却デバイス、等)</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)	 <p>WIRE Japan Show 2024</p> <p>電気・光伝送技術展</p> <p>ワイヤー・ケーブルを用いる伝送技術全般(産業用機器/電線、ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線、ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞((株)工業通信)	 <p>Electronics Component &amp; Unit Show</p> <p>半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合	 <p>E-Textile/Wearable</p> <p>イーテキスタイル/ウェアラブル展</p> <p>電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社織研新聞社

センサー技術	無人化技術・ソリューション	エッジソリューション・オンデバイス技術
 <p>スマートセンシング</p> <p>センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン	 <p>無人化ソリューション展</p> <p>労働力不足を解消し製造工程の無人化、省人化を支援する無人化技術・ソリューション、または無人化のための省力化・遠隔化・自動化・非接触化の技術・ソリューション全般</p> <p>監視システム/遠隔操作システム/先進運転支援システム/ディープレーンング/非接触・タッチレス/無人営業サービス/AR/異常検知/顔認証/AI等</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン	 <p>エッジコンピューティング</p> <p>オンデバイス技術、低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般</p> <p>ボードコンピュータ・シングルボードコンピュータ/エッジデバイス/OS/エッジAI/アプリケーション/画像分析/エッジセキュリティ/各種システム 等</p> 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

## NEW アプリケーションゾーンの設置 (ゾーンへの出展をご希望の場合は、出展申込時にゾーンを選択してください。)

自動運転 自動運転向け高速伝送技術ゾーン	EV EV向け大電流技術ゾーン	パワー半導体/ガラス基板 パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術ゾーン
アドバンスドパッケージ チップレット等の最先端半導体パッケージング技術ゾーン	気候変動対策 気候変動対策に寄与する低エミッション技術ゾーン	

## 2023年開催実績

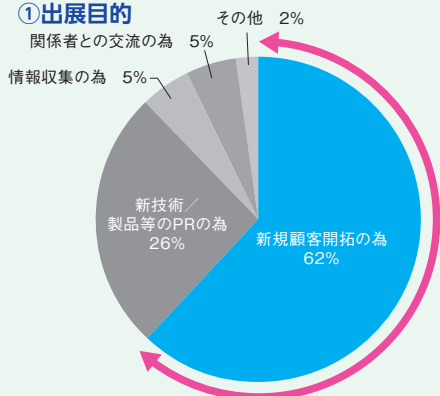
会場 **東京ビッグサイト 東展示棟**

出展規模 **517社 / 1,273小間** 来場者数 **48,018名**

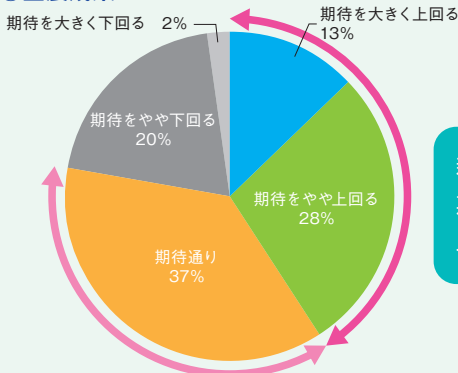
## 2023年展実績

### ● 出展者アンケート

#### ① 出展目的

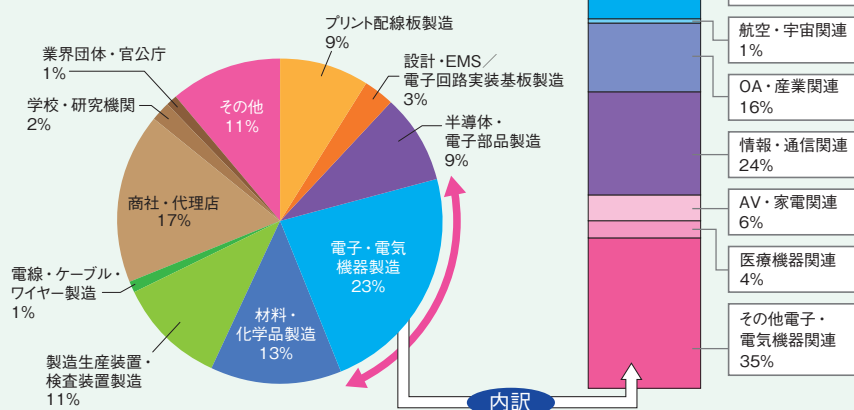


#### ② 出展成果



新規顧客開拓を目的に出展し、41%の出展者は期待を上回る成果を、78%の出展者は期待通り以上の成果をあげる。

### ● 来場者業種分類



従来の電子・電気機器製造来場者にとどまらず、新しいアプリケーション分野の来場者層とのネットワークが期待できる。

## 注目 新しいネットワーク形成の場を提供

「出展者交流会」を開催し、出展者間のネットワーキングを促進します！

「学生ウェルカムブース」「交流プラザ」を設置し、エレクトロニクスの明日を担う若い世代を歓迎します！

## 来場実績

### ◆ 多種多様な業種・業界よりご来場！

半導体、通信、モビリティ(自動車、二輪車、自転車)、船舶、電車、航空機、農業、交通インフラ、ロジスティクス、ゲーム・玩具、メタバース、AI、AR/VR、各種システム・ソリューションプロバイダー、林業、水産業、食品、教育、医療/ヘルスケア、運輸、アパレル/スポーツ用品、金融、地方自治体、美容、スマート家電、防衛装備、e-Sports、AV、ドローン、ウェアラブル機器、センサー、防災、ロボット、バイオメトリクス、エネルギー、Dx/Gx/Cx/Sx、観光Dx、サイネージ、スマートx、等

AGC、AmkorTechnology、CKD、DIC、HUAWEI、JAグループ、JFEグループ、JR東日本グループ、JSR、JTB、JVCケンウッド、KDDIグループ、LGグループ、LIXIL、NECグループ、NHKテクノロジーズ、NTN、NTTグループ、Rapidus、SKグループ、SMBCグループ、SUBARU、SUMCO、TDK、THK、TOTO、TSMCグループ、YKK、アイシングループ、アサヒ飲料、イオングループ、インテル、オカムラ、オムロングループ、オリンパス、カシオ計算機、カナダ国立研究機構、関西電力グループ、キャノン、きんでん、クボタ、シチズン時計グループ、シャープ、シャチハタ、セイコーウオッチ、日本ゼオン、セコム、ソニーグループ、ソフトバンク、タイガー魔法瓶、ダスキン、テルモ、テレビ埼玉、テレビ東京、デロイトトーマツコンサルティング、デンソーグループ、トーエネック、トヨタ自動車、トヨタ車体、ニコン、ニプログループ、ノリタケカンパニーリミテド、パーク24、長谷工グループ、パナソニックグループ、ヒロセ電機、フォスター電機、ブラザー工業、プリジストングループ、ホシデン、ミサワホームグループ、みずほグループ、ヤマハ、リコー、りそなグループ、リンナイ、レゾナック、レノボジャパン、ロームグループ、愛三工業、愛知製鋼、旭化成、安川リニューアブル、伊藤忠商事、宇宙航空研究開発機構、横河電機、横浜銀行、横浜国立大学、加賀電子、華為技術日本、丸紅、岩谷産業、京セラ、九州大学、九州電力、慶應義塾大学、兼松、古河電気工業、戸田建設、黒田電気、三井化学、三菱UFJ銀行、三菱自動車工業、三菱商事、三菱総合研究所、三菱電機、三和シャッター工業、産業技術総合研究所、資生堂、鹿児島県、住友商事、住友電装、出光興産、商工組合中央金庫、小糸製作所、小森コ・ホーシヨウ、森永乳業、清水建設、川崎重工業、倉敷紡績、早稲田大学、総合警備保障、村田製作所、太陽誘電、大阪産業技術研究所、大阪大学、大日本印刷、大林組、大和ハウス工業、帝人、島津製作所、東レ、東海理化、東京エレクトロン、東京ガス、東京消防庁、東京大学、東京地下鉄、東芝グループ、東北大学、東洋紡、南亜グループ、日亜化学工業、日産自動車、日東紡、日本IBM、日本サムスン、日本テキサス・インスツルメンツ、日本ハネウェル、日本経済新聞社、日本東洋、日本無線、日立造船、農業食品産業技術総合研究機構、富士キメラ総研、富士ソフト、富士フィルムグループ、富士通グループ、豊田合成、豊田自動織機、本田技研工業、明電舎、野村総合研究所、野村證券、矢崎総業、矢野経済研究所、等 (順不同・敬称略)

● 海外来場者：27か国・地域から来場

## ■ 出展料金

区分		1小間 / 9m <sup>2</sup>
一般		496,100円(税込)
会員企業*1	通常	423,500円(税込)
	早期	396,880円(税込)
	20小間以上	372,075円(税込)

\*1 対象：JPCA会員 / JIEP正会員・賛助会員 / JARA正会員・賛助法人会員 / JEP・TEP正会員  
※1小間のサイズは、3m×3m=9m<sup>2</sup>です。  
※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

## ■ 出展申込 (2023年11月1日 (水) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)  
出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。  
貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。  
専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。  
出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

## ■ 申込締切

早期申込締切日(対象:会員企業)	2024年1月31日(水)
最終申込締切	2024年2月29日(木)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。  
※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

## ■ 取消料

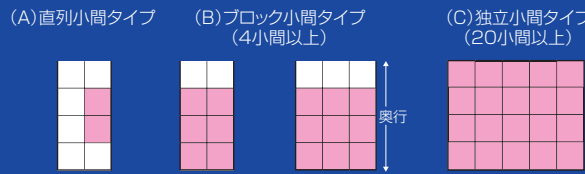
出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月29日(木)	小間料金の 30%
3月1日(金)～3月31日(日)	小間料金の 50%
4月1日(月)～4月30日(火)	小間料金の 70%
5月1日(水)～	小間料金の100%

## ■ 開催までのスケジュール

2023年11月	2024年1月	2月	3月	4月	5月	6月
▲ 11月1日(水) 10:00～ 出展申込受付開始	▲ 1月31日(水) 出展早期申込締切 (対象:会員企業)	▲ 2月29日(木) 出展最終申込締切	▲ 3月中旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開  ▲ 3月下旬 小間位置選択会開催	▲ 4月中旬 招待状発送 来場登録開始		▲ 6月10日(月)～11日(火) 搬入期間  6月12日(水)～14日(金) 展示会開催  ※最終日即日撤去
← 3月中旬～随時 各種提出書類期限 →						

## ■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

## ■ 小間位置の決定

小間位置選択会(2024年3月下旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。

原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。

※詳細は出展規約をご確認ください。

## ■ 出展者サポートプログラム 有料・オプション

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

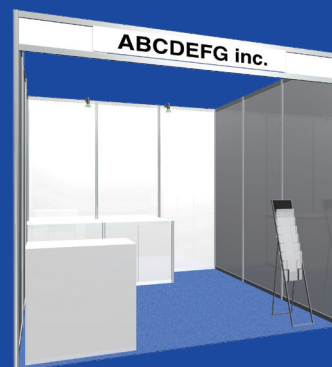
※詳細は別途出展者説明会(2024年3月中旬開催予定)でご案内します。

## ■ パッケージブースプランのご案内 有料・オプション

### ● 1小間ベーシックプラン

価格(予定)：¥118,800(税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。詳細は出展者説明会(2024年3月中旬開催予定)にて配布する資料をご確認ください。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会  
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階  
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン  
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング  
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ